

关于深圳市福田区政协会议委员提案第 2025296 号《关于推动车规级芯片国产化发展的 若干建议》的答复

尊敬的委员：

您提出的《关于推动车规级芯片国产化发展的若干建议》第 2025296 号提案已收悉。提案深入分析了产业发展现状，并就策略选择、政策扶持、协同创新、资金支持、人力支援等方面提出了具有前瞻性的意见建议。对此，我们表示衷心感谢。经认真研究，结合福田区工作实际，现答复如下：

福田区将车规级芯片国产化作为完善集成电路产业链、提升产业核心竞争力的重要抓手，通过跨区域协同、政策赋能等举措构建产业创新发展生态。目前，全区已初步形成覆盖设计、集成、制造等环节的产业链条：上游集聚华大九天等 EDA 工具龙头企业；中游拥有微源半导体（电源管理芯片）、希格玛和芯（高精度 ADC/车载音频芯片）、元视芯（智能视觉处理芯片）、汇顶科技（人机交互芯片）等细分领域领军企业；下游布局联友科技、众鸿科技等系统集成商，以及元戎启行、佑驾创新等智能驾驶企业。

一、关于策略选择建议的答复

福田区坚持“细分领域重点突破”策略，培育了一批具有核

心竞争力的企业。微源半导体车规级电源管理芯片已广泛应用于智能座舱、ADAS 系统等领域；希格玛和芯的高精度 ADC 和车载音频芯片通过车规级认证并实现量产；近期新引进的元视芯在智能视觉处理芯片领域形成独特技术优势。通过精准扶持，推动企业在细分领域构建差异化竞争优势。

二、关于政策扶持建议的答复

深圳市已出台《促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》，对车规级芯片等核心环节按项目总投资一定比例给予最高 3000 万元资助。《促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》对研发投入按 30% 给予最高 1000 万元支持，对芯片销售按 15% 给予最高 1000 万元奖励。福田区正加快修订集成电路专项政策，涵盖技术攻关、平台建设、研发投入等全方位支持，2025 年 9 月 30 日，《深圳市福田区支持半导体与集成电路产业集群发展若干措施（征求意见稿）》已挂网公开向社会征求意见，预计第四季度将正式出台。同时，福田-博罗产业园区（占地 102 亩，建筑面积 11.7 万平方米）可为高端封测等环节提供专业化空间载体。

三、关于协同创新建议的答复

鼓励区内企业积极参与深圳市集成电路产业联盟、深圳市芯片科技促进会等相关产业联盟、行业协会等，推动产业链协同创新发展。推动英飞凌、华大九天等国内外龙头企业在福田深化布局，强化技术协同，促进产业链要素资源加速集聚；通过组织技

术交流、供需对接等活动，促进芯片企业与整车厂、零部件供应商深度合作。华大九天作为国内 EDA 领军企业，其工具链为车规级芯片设计提供重要支撑，有效推动国产 EDA 软件生态建设。

四、关于资金支持建议的答复

依托香蜜湖新金融中心等重要载体，构建覆盖企业全生命周期的多层次资本市场服务体系。一是常态化组织集成电路等领域的专项投融资对接活动，积极推动优质芯片企业与深创投、高新投等知名投资机构开展深度合作。二是充分发挥政府引导基金的撬动作用，通过参股市场化子基金，为科技创新企业提供多元化的股权融资支持。福田区新设规模达 5 亿元的产业协同发展基金，集成电路产业是该基金的重点投资领域之一，元视芯等企业预计将获得投资。三是持续落实科技金融相关政策，通过贷款贴息、风险补偿等机制，有效降低企业融资成本。目前，元戎启行、佑驾创新等一批企业已实现多轮融资，充分体现了资本市场的高度认可与信心。

五、关于人力支援建议的答复

在人才支撑方面，福田区通过多种渠道为产业发展提供智力支持。一方面，依托“福田英才荟”人才政策，为集成电路领域的高层次人才提供全方位服务保障，2025 年 5 月-8 月，“福田英才荟集成电路研发人才奖励 ” 已完成受理，对近三年集成电路类机构承担市级以上项目或上年度研发投入占营收 15%以上的，给予芯片设计、流片、高端封测、软件算法及化合物半导体等研

发团队最高 30 万元奖励。另一方面，充分利用河套合作区区位和政策优势，支持建设河套学院，聚焦人工智能领域前沿技术攻关、成果转化与高端人才培养；鼓励澳门大学河套集成电路研究院与国内半导体企业积极进行产学研合作，共同开发自主知识产权的芯片，充分发挥澳门大学集成电路国家重点实验室科技引领作用，积极推进实验室技术成果的转移转化。

基于当前工作基础和您的宝贵建议，我局下一步将重点推动以下工作：一是强化政策引导与精准扶持。加快推进《深圳市福田区支持半导体与集成电路产业集群发展若干措施》出台进度，积极落实深圳市相关政策，支持企业申报车规级芯片研发及产业化项目，争取市级资金支持。二是构建产业协同创新体系。依托深圳市集成电路产业联盟等平台，建立“芯片设计-整车应用”对接机制，定期组织供需对接会。三是拓展产业发展空间载体。加快推进福田-博罗产业园区建设，重点引进车规级芯片封装测试、模块制造等环节企业，力争在国产车规级芯片供给侧的做出更多贡献。

福田区科技和工业信息化局

2025 年 10 月 17 日